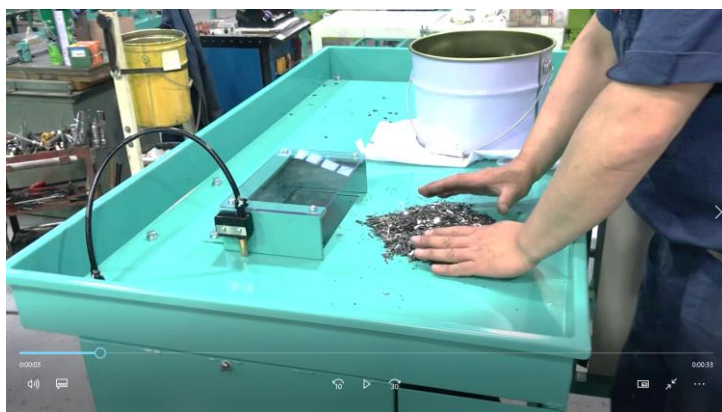




強靱な2軸破砕ロールで小さな半導体部品を確実に破砕

ロールクラッシャーは半導体部品（チップ・モールド・ダイオード・ウェーハ）の機能破壊や貴金属リサイクルを目的としたすり潰し圧砕方式の破砕機。半導体部品生産段階で発生する規格外品や生産不良品など廃棄時には、情報漏えい防止・機密保持のため機能破壊する事が必要です。

また、半導体部品には金・銀などの貴金属が含まれている場合も多く、貴金属精錬の前処理工程としても活躍しています。



ラインナップ

RCL-N型 高性能



極小チップにも対応できる
電動クリアランス調整の高性能モデル

大きさ	930L×1650W×990H
重量	約 650kg
動力	3相 200V 4.1kw (3.7kw+0.4kw)
破砕ロール	Φ152×250 L 高周波焼入 & 超硬溶射
スキマ調整	電動デジタル式
対象ワーク	厚み0.5～30mm 巾～180mm
処理能力	20～100kg/H

R-C L型 スタンダード



手動ハンドル調整のスタンダードモデル

大きさ	720L×1320W×960H
重量	約 550kg
動力	3相 200V 3.7kw
破砕ロール	Φ152×200 L 高周波焼入
スキマ調整	手動ハンドル式
対象ワーク	厚み1～20mm 巾～180mm
処理能力	20～100kg/H

処理例

BEFORE



AFTER

